


Dell EMC PowerEdge T550

技术规格

注意：此内容由人工智能 (AI) 翻译，其中可能含有错误之处，翻译按“原样”提供，且不做任何形式的保证。如需查看原始（未翻译）内容，请参阅英文版。如果您对此内容有任何疑问或疑虑，请通过 Dell.Translation.Feedback@dell.com 联系戴尔。

注意、小心和警告

 **注:** “注意” 表示可帮助您更好地使用产品的重要信息。

 **小心:** “小心” 表示可能会导致硬件损坏或数据丢失，并告诉您如何避免问题。

 **警告:** “警告” 表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

章 1: 技术规格	4
机箱尺寸.....	5
系统重量.....	5
处理器规格.....	6
PSU 规格.....	6
冷却风扇规格.....	7
支持的操作系统.....	8
系统电池规格.....	8
扩展卡提升板规格.....	8
内存规格.....	8
存储控制器规格.....	9
驱动器规格.....	9
驱动器.....	9
光驱.....	9
端口和连接器规格.....	10
USB 端口规格.....	10
NIC 端口规格.....	10
VGA 端口规格.....	10
串行连接器规格.....	10
视频规格.....	10
环境规格.....	11
散热限制列表.....	12
微粒和气体污染规格.....	15
散热空气限制.....	16

技术规格

本节概述了系统的技术规格和环境规格。

主题：

- 机箱尺寸
- 系统重量
- 处理器规格
- PSU 规格
- 冷却风扇规格
- 支持的操作系统
- 系统电池规格
- 扩展卡提升板规格
- 内存规格
- 存储控制器规格
- 驱动器规格
- 端口和连接器规格
- 视频规格
- 环境规格

机箱尺寸

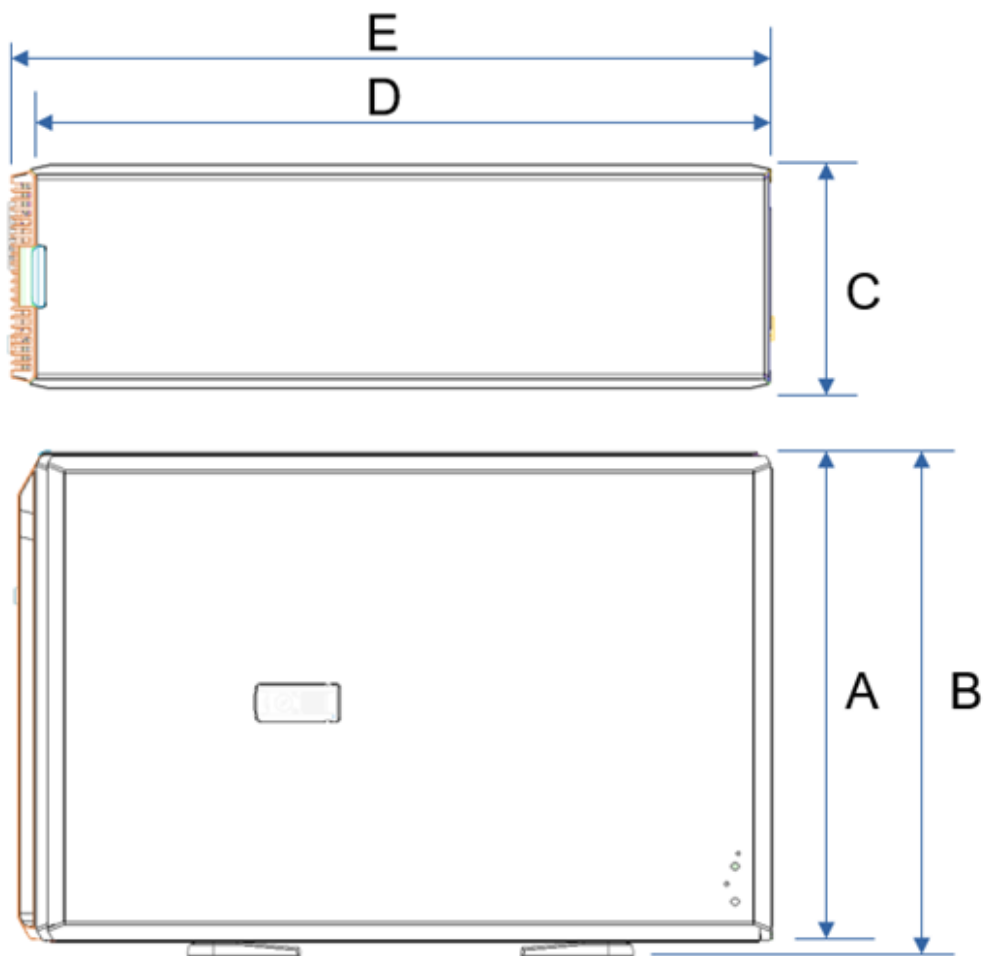


图 1: 机箱尺寸

表. 1: 系统的机箱尺寸

驱动器	A	B	C	D	E (带挡板)
24 x 2.5 英寸 / 8 x 3.5 英寸 + 8 x 2.5 英寸 NVMe	446.0 毫米 (17.60 英寸)	464.0 毫米 (18.27 英寸)	200.0 毫米 (7.87 英寸)	663.5 毫米 (26.12 英寸)	680.5 毫米 (26.79 英寸)

注: Zb 是系统板 I/O 连接器所在的极小后壁外表面。

系统重量

表. 2: PowerEdge T550 系统的系统重量

系统配置	最大重量 (包括所有驱动器/SSD)
8 x 3.5 英寸 + 8 x 2.5 英寸 NVMe	44.48 千克 (98.06 磅)
24 x 2.5 英寸 SAS/SATA	44.1 千克 (97.22 磅)

处理器规格

表. 3: 系统的处理器规格

支持的处理器	支持的处理器数量
第 3 代英特尔至强可扩展处理器带多达 32 个核心	多达两个

PSU 规格

PowerEdge T550 系统支持多达两个交流电源装置 (PSU)。

表. 4: PSU 规格

PSU	分类	散热量 (最大值)	频率	电压	交流		直流	电流
					高压线路 200 - 240 V	低压线路 100 - 120 V		
600 W 混合模式	白金级	2250 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V, 自动调节范围	600 W	600 W	不适用	7.1 A - 3.6 A
	不适用	2250 BTU/小时	不适用	240 V 直流	不适用	不适用	600 W	2.9 A
800 W 混合模式	白金级	3000 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V, 自动调节范围	800 W	800 W	不适用	9.2 A - 4.7 A
	不适用	3000 BTU/小时	不适用	240 V 直流	不适用	不适用	800 W	3.8 A
1100 W DC	不适用	4265 BTU/小时	不适用	-48 V DC - (-60) V DC	不适用	不适用	1100 W	27 A
1100 W 混合模式	钛金级	4125 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V	1100 W	1050 W	不适用	12 A - 6.3 A
	不适用	4125 BTU/小时	不适用	240 V 直流	不适用	不适用	1100 W	5.2 A
1400 W 混合模式	白金级	5250 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V	1400 W	1050 W	不适用	12 A - 8 A
	不适用	5250 BTU/小时	不适用	240 V 直流	不适用	不适用	1400 W	6.6 A
2400 W 混合模式	白金级	9000 BTU/小时	50/60 Hz	100 - 240 V	2400 W	1400 W	不适用	16 A - 13.5 A
	不适用	9000 BTU/小时	不适用	240 V 直流	不适用	不适用	2400 W	11.2 A
700 W 混合模式	钛金级	2625 BTU/小时	50/60 Hz	200 - 240 V AC	700 W	不适用	不适用	4.1 A

表. 4: PSU 规格 (续)

PSU	分类	散热量 (最大值)	频率	电压	交流		直流	电流
					高压线路 200 - 240 V	低压线路 100 - 120 V		
	不适用	2625 BTU/小时	不适用	240 V 直流	不适用	不适用	700 W	3.4 A
1800 W 混合模式	钛金级	6000 BTU / 小时	50/60 Hz	200 - 240 V AC	1800 W	不适用	不适用	10 A
	不适用	6000 BTU / 小时	不适用	240 V 直流	不适用	不适用	1800 W	8.2 A

① 注: 此系统也可连接相间电压不超过 240 V 的 IT 电源系统。

① 注: 散热量是使用 PSU 的额定功率来计算的。

① 注: 选择或升级系统配置时, 为了确保最佳电源利用率, 请使用 Dell.com/calc 上的企业基础架构规划工具验证系统功耗。

冷却风扇规格

PowerEdge T550 系统支持多达八个标准或高性能银牌级 (HPR [银牌]) 散热风扇, 直接连接到系统板。

表. 5: 冷却风扇规格

风扇类型	简写	也称为	标签颜色	标签图像
高性能 (银牌级) 风扇	HPR (银牌级)	HPR — 高性能	不适用	 <p>图 2: 高性能风扇</p>
标准风扇	STD	STD - 标准	不适用	 <p>图 3: 标准风扇</p>

① 注: 有关支持的风扇配置或值表的详细信息, 请参阅 [散热限制值表](#)。

支持的操作系统

PowerEdge T550 系统支持以下操作系统：

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

有关详情，请转至 [操作系统支持](#)。

系统电池规格

PowerEdge T550 系统支持 CR 2032 3.0 V 纽扣锂电池系统电池。

扩展卡提升板规格

系统支持多达六个 PCI Express (PCIe) 4.0 扩展卡。

表. 6: 扩展卡插槽支持值表

PCIe 插槽	处理器 1	平台控制器集线器 (PCH)	处理器 2
	内部	内部	内部
插槽 1	x16	-	-
插槽 2	-	-	x16
插槽 3	-	-	x16
插槽 4	-	-	x16
插槽 5	-	x8	-
插槽 6	x16	-	-

表. 7: 提升板配置支持的扩展卡插槽

PCIe 插槽	提升板配置	提升板宽度	支持 PERC	支持的背面存储
插槽 1	GPU 提升板	x16 PCIe	否	否
插槽 2	GPU 提升板	x16 PCIe	否	否

内存规格

系统支持以下内存规格以优化操作。

表. 8: 内存规格

DIMM 类型	DIMM 列	DIMM 容量		DIMM 的额定电压和支持的速度	速度	
		单处理器	双处理器		单处理器	双处理器
RDIMM	单列	8 GB	16 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933
		16 GB	32 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933
	双列	16 GB	32 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933

表. 8: 内存规格 (续)

DIMM 类型	DIMM 列	DIMM 容量		DIMM 的额定电压和支持的速度	速度	
		单处理器	双处理器		单处理器	双处理器
		32 GB	64 GB	DDR4 (1.2 V)、3200	3200	2933

表. 9: 内存模块插槽

内存模块插槽	速度
16, 288 针	3200 MT/s、2933 MT/s、

存储控制器规格

PowerEdge T550 系统支持以下控制器卡:

表. 10: 存储控制器卡

内部控制器	外部控制器
<ul style="list-style-type: none"> • S150 • PERC H345 • H355 • PERC H755 • H755N • HBA355i • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRaid 2 x M.2 SSD 	<ul style="list-style-type: none"> • HBA355e • PERC H840

驱动器规格

驱动器

PowerEdge T550 系统支持:

- 多达 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA/ (HDD) 驱动器
- 多达 16 x 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD) 驱动器
- 多达 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA/ (HDD) 驱动器
- 多达 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA/ (HDD/SSD) 驱动器
- 多达 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 8 x 2.5 英寸 NVMe (HDD/SSD) 驱动器

i 注: 有关如何热插拔 NVMe PCIe SSD U.2 设备的更多信息, 请参阅《Dell Express Flash NVMe PCIe SSD 用户指南》, 网址: [戴尔支持页面](#) [浏览所有产品](#) > [数据中心基础架构](#) > [存储适配器和控制器](#) > [Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD](#) > [文档](#) > [手册和文档](#)。

光驱

PowerEdge T550 系统支持一个超薄 SATA DVD-ROM 驱动器。

i 注: DVD 设备仅支持数据。

端口和连接器规格

USB 端口规格

表. 11: USB 规格

正面		背面	
USB 端口类型	服务器数	USB 端口类型	服务器数
与 USB 2.0 兼容的端口	一声	USB 3.0 兼容端口	一声
与 USB 3.0 兼容的端口	一声	与 USB 2.0 兼容的端口	一声
iDRAC 直接端口 (Micro-AB USB 2.0 兼容端口)	一声		

i 注: 前置 Micro USB 2.0 兼容端口仅适用于追加销售配置。

i 注: Micro USB 2.0 兼容端口只可以用作 iDRAC Direct 或管理端口。

i 注: USB 2.0 规格提供了一个单线 5 V 电源装置, 用于为连接的 USB 设备供电。设备负载在 USB 2.0 中定义为 100 mA, 在 USB 3.0 中定义为 150 mA。设备可能会从 USB 2.0 中的端口最多消耗 5 个设备负载 (500 mA); 从 USB 3.0 消耗 6 个设备负载 (900 mA)。

i 注: USB 2.0 接口可为低功率外围设备供电, 但必须符合 USB 规格。要运行高级外围设备 (例如外部 CD/DVD 驱动器), 需要外部电源。

NIC 端口规格

系统支持嵌入在主板 LAN (LOM) 上以及集成在可选的 OCP 卡上的多达两个 10/100/1000 Mbps 网络接口控制器 (NIC) 端口。

表. 12: 系统的 NIC 端口规格

功能部件	规格
LOM 卡	1 GB x 2
OCP 卡 (OCP 3.0)	1 GbE x 4、10 GbE x 2、25 GbE x 2、25 GbE x 4、50 GbE x 2、100 GbE x 2

VGA 端口规格

系统支持一声 DB-15 VGA 端口, 前面板和背面板上各一个。

串行连接器规格

PowerEdge T550 系统支持一个可选的插卡类型串行接头, 该 9 针接头是兼容 16550 的数据终端设备 (DTE)。

可选的串行连接器卡安装类似于扩展卡填充挡片支架。

视频规格

系统支持集成 Matrox G200 显卡控制器, 带 16 MB 视频帧缓存。

表. 13: 系统支持的背面视频分辨率选项

分辨率	刷新率 (Hz)	颜色深度 (位)
1024 x 768	60	8、16、32
1280 x 800	60	8、16、32
1280 x 1024	60	8、16、32
1360 x 768	60	8、16、32
1440 x 900	60	8、16、32
1600 x 900	60	8、16、32
1600 x 1200	60	8、16、32
1680 x 1050	60	8、16、32
1920 x 1080	60	8、16、32
1920 x 1200	60	8、16、32

环境规格

i 注: 有关环境认证的其他信息, 请参阅手册和说明文件中的“产品环境数据表”, 网址: 。

表. 14: 工作气候范围类别 A2

温度	规格
可允许连续工作	
海拔高度 <= 900 米 (<= 2,953 英尺) 的温度范围	在设备无直接光照的情况下, 10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
湿度百分比范围 (所有时间均非冷凝)	8% RH 和 -12°C 最低露点到 80% RH 和 21°C (69.8°F) 最大露点
工作海拔高度降幅	超过 900 米 (2953 英尺) 时, 最高温度按 1°C/300 米 (33.8°F/984 英尺) 降低

表. 15: 工作气候范围类别 A3

温度	规格
可允许连续工作	
海拔高度 <= 900 米 (<= 2,953 英尺) 的温度范围	在设备无直接光照的情况下, 5–40°C (41–104°F)
湿度百分比范围 (所有时间均非冷凝)	8% RH 和 -12°C 最低露点到 80% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点
工作海拔高度降幅	最高温度超过 900 米 (2953 英尺) 以上时按 1°C/175 米 (1.8°F/574 英尺) 降低

表. 16: 工作气候范围类别 A4

温度	规格
可允许连续工作	
海拔高度 <= 900 米 (<= 2,953 英尺) 的温度范围	在设备无直接光照的情况下, 5–45°C (41–113°F)
湿度百分比范围 (所有时间均非冷凝)	8% RH 和 -12°C 最低露点到 80% RH 和 24°C (75.2°F) 最大露点
工作海拔高度降幅	最高温度超过 900 米 (2953 英尺) 以上时按 1°C/125 米 (1.8°F/410 英尺) 降低

i 注: 某些系统硬件配置可能需要操作温度低于 28°C。有关更多信息, 请参阅散热空气限制部分。

表. 17: 所有类别的共享要求

温度	规格
可允许连续工作	
最大温度梯度 (适用于操作时和非操作时)	20°C (一小时) * (36°F [一小时]) 和 5°C (15 分钟) (41°F [15 分钟])、5°C (一小时) * (41°F [一小时]) - 针对磁带 注: * 根据适用于磁带硬件的 ASHRAE 的散热原则, 这些不是温度变化的瞬时速率。
非操作温度限制	-40 至 65°C (-104 至 149°F)
非操作湿度限制	最大露点为 27°C (80.6°F) 时, 相对湿度为 5% 至 95%
最大非工作海拔高度	12,000 米 (39,370 英尺)
最大工作海拔高度	3,048 米 (10,000 英尺)

表. 18: 最大振动规格

最大振动	规格
使用时	5 Hz 至 500 Hz 时, 0.21 G _{rms} (所有操作方向)
存储	10 Hz 至 500 Hz 时, 1.88 G _{rms} , 可持续 15 分钟 (被测的所有六面)

表. 19: 最大撞击脉冲规格

最大撞击脉冲	规格
使用时	在 x、y 和 z 轴正负方向上可承受 6 G 连续执行的撞击脉冲, 最长可持续 11 毫秒。
存储	x、y 和 z 轴正负方向上可承受连续六个 71 G 的撞击脉冲 (系统每一面承受一个脉冲), 最长可持续 2 毫秒。

散热限制列表

表. 20: 散热限制列表

驱动器配置	处理器	风扇	CPU TDP	风扇冗余	CPU HSK		GPU 支持		TBU 支持	CPU 挡片	风扇挡片	注	GPU 转接卡配置	
					TDP>150 W	TDP<=150 W	GPU<=75 W	GPU>75 W						
8 x 3.5	1	STD x3	<=185	否, 追加销售 STDx6 选项	HPR HSK	STD HSK	否	否	否	是	是, 位于风扇 2 的位置	风扇 1/3/4	转接卡 0、1	
	1	STD x6	<=220	是			否	否	否	是		风扇 1/3/4/5/7/8	转接卡 0、1	
	1	HPR x3	<=220	否, 追加销售 HPRx6 选项			是	否	否	是		风扇 1/3/4	否	
	1	HPR x5*	<=220	是			是/否	否	是	是		风扇 1/3/4/7/8 (不支持 GPU 转接卡 1 和 2)	否	
	1	HPR x6	<=220	是			是	是	否	是		风扇 1/3/4/5/7/8	是	
	2	STD x4	<=185	否, 追加销售 STDx8 选项			否	否	否	否		否	不适用	转接卡 0、1
	2	STD x8	<=220	是			否	否	否	否		不适用	转接卡 0、1	
	2	HPR x4	<=220	否, 追加销售 HPRx8 选项			是	否	否	否		不适用	否	
	2	HPR x7*	<=220	TBD			是/否	否	是	否		风扇 1/2/3/4/6/7/8 ①注: 不支持 GPU 转接卡 1 和 2	否	
	2	HPR x8	<=220	是			是	是	否	否		不适用	是	
8 x 2.5 16 x 2.5 24 x 2.5	1 或 2	STD x4	<=185	否, 追加销售 STDx8 选项	HPR HSK	STD HSK	否	否	否	是, 适用于 1 个处理器	否	不适用	转接卡 0、1	

表. 20: 散热限制列表 (续)

驱动器配置	处理器	风扇	CPU TDP	风扇冗余	CPU HSK		GPU 支持		TBU 支持	CPU 挡片	风扇挡片	注	GPU 转接卡配置
					TDP>150 W	TDP<=150 W	GPU<=75 W	GPU>75 W					
	1 或 2	STD x8	<=220	是			否	否	否			不适用	转接卡 0、1
	1 或 2	HPR x4	<=220	否, 追加销售 STDx8 选项			是	否	否			不适用	否
	1 或 2	HPR x7*	<=220	是			是/否	否	是			风扇 1/2/3/4/6/7/8 ①注: 不支持 GPU 转接卡 1 和 2	否
	1 或 2	HPR x8	<=220	是			是	是	否			不适用	是
8 x 3.5 + 8 x 2.5 (NVMe)	1 或 2	HPR x4	<=220	否, 追加销售 HPRx8 选项	HPR HSK	STD HSK	是	否	否	是, 适用于 1 个处理器	否	不适用	无或转接卡 0、1、2
	1 或 2	HPR x7*	<=220	是			是/否	否	是			风扇 1/2/3/4/6/7/8 ①注: 不支持 GPU 转接卡 1 和 2	否
	1 或 2	HPR x8	<=220	是			是	是	否			不适用	是

- ① **注:** 所有驱动器配置都需要 OCP 导流罩，即使未安装 OCP 卡也是如此。
- ① **注:** CPU TDP>185 W 时需要 DIMM 挡片，但 CPU TDP ≤185 W 时不需要 DIMM 挡片。
- ① **注:** 在 GPU 转接卡插槽 1 上安装 GPU>75 W 时，GPU 转接卡插槽 2 中需要 GPU 挡片。
- ① **注:** 留空的 HDD 插槽需要 HDD 挡片。
- ① **注:** * x5 和 x7 风扇计数仅适用于 TBU 配置。不带 TBU 的系统不应使用 x5 和 x7 风扇计数。对于 TBU 配置，环境温度 <35C。
- ① **注:** 选择 GPU 时，必须需要 HPR 风扇。
- ① **注:** GPU>75 W 必须需要风扇冗余（风扇数量 = 6 或 8）。
- ① **注:** GPU>75 W 不支持 TBU。
- ① **注:** STD 风扇也可以升级到 HPR 风扇。

所有配置的散热值表

表. 21: 所有配置的散热值表

-		8x、16x、24x 2.5 英寸 SAS/SATA 配置 1				8x 3.5 英寸配置 2				8x 3.5 英寸 + 8x 2.5 英寸 NVMe 配置 3	
风扇		STDx4	STDx8	HPRx4	HPRx7 x8	STDx3 x4	STDx6 x8	HPRx3 x4	HPRx5 x6 x7 x8	HPRx4	HPRx7 x8
风扇冗余		否	是	否	是	否	是	否	是	否	是
最大 DIMM 功率		12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W	12 W
CPU TDP	105 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	120 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	125 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	135 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	150 W	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK	STD HSK
	165 W	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK
	185 W	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK
	205 W	不支持	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	不支持	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK
220 W	不支持	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	不支持	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	HPR HSK	

微粒和气体污染规格

下表定义了限制范围，帮助避免任何 IT 设备损坏和/或微粒和气体污染故障。如果颗粒或气体污染级别超过指定的限制范围并导致设备损坏或发生故障，您可能需要改善环境条件。整改环境条件是客户的责任。

表. 22: 微粒污染规格

微粒污染	规格
空气过滤	按照 ISO 14644-1 第 8 类定义的拥有 95% 置信上限的数据中心空气过滤。 ⓘ 注: 此情况仅适用于数据中心环境。空气过滤要求不适用于旨在数据中心之外 (诸如办公室或工厂车间等环境) 使用的 IT 设备。 ⓘ 注: 进入数据中心的空气必须拥有 MERV11 或 MERV13 过滤。
导电灰尘	空气中不得含有导电灰尘、锌晶须或其他导电颗粒。 ⓘ 注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。
腐蚀性灰尘	<ul style="list-style-type: none"> 空气中不得含有腐蚀性灰尘。 空气中的残留灰尘的潮解点必须小于 60% 相对湿度。 ⓘ 注: 此条件适用于数据中心和非数据中心环境。

表. 23: 气体污染规格

气体污染	规格
铜片腐蚀率	<300 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-2013 定义的 G1 类标准
银片腐蚀率	<200 Å/月, 按照 ANSI/ISA71.04-2013 定义的标准

ⓘ 注: 腐蚀性污染物最大浓度值在小于等于 50% 相对湿度下测量。

散热空气限制

不同配置的散热空气限制

表. 24: 8 x 3.5 英寸驱动器配置

标准操作支持 (符合 ASHRAE A2) ⓘ 注: 除非另有说明, 否则支持所有选项。	扩展环境 40°C 操作支持 (符合 ASHRAE A3 标准)	扩展环境 45°C 操作支持 (符合 ASHRAE A4 标准)
<ul style="list-style-type: none"> 3 个或 4 个 STD 风扇仅支持 TDP <= 185 W 的处理器 使用 STD 风扇时, 以下 OCP 3.0 和 NIC 仅支持带散热规格为 85C 并且电源 <= 1.2 W 的光缆 <ul style="list-style-type: none"> Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28 Broadcom PCIe QP 25G NVIDIA CX6-LX PCIe 双端口 25G SFP28 (在插槽 6 中) 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持 3 个或 4 个 STD 风扇配置。 不支持 6 个或 8 个处理器 TDP > 120 W 的 STD 风扇配置。 TBU 不受支持。 不支持不符合戴尔标准的外围设备卡和通道设备 (FW) 卡。 不支持 NIC 功耗 >= 25 W。例如: CX6 卡。 不支持 OCP 传输速率 > 25 G 或冷却层 > 10。 需要规格为 85C 的光缆。 需要两个 PSU。在 PSU 故障的情况下, 系统性能可能会降低。 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持 STD 风扇配置。 不支持 CPU TDP > 165 W 的 3 个或 4 个 HPR 风扇配置。 TBU 不受支持。 不支持 BOSS M.2 模块。 不支持不符合戴尔标准的外围设备卡和通道设备 (FW) 卡。 NIC 功耗 >= 25 W。例如: CX6 卡。 不支持 OCP 传输速率 > 25 G 或冷却层 > 10。 需要规格为 85C 的光缆。 需要两个 PSU。在 PSU 故障的情况下, 系统性能可能会降低。

表. 25: 8 x 2.5 英寸、16 x 2.5 英寸、24 x 2.5 英寸驱动器配置

标准操作支持 (符合 ASHRAE A2)	扩展环境 40°C 操作支持 (符合 ASHRAE A3 标准)	扩展环境 45°C 操作支持 (符合 ASHRAE A4 标准)
<ul style="list-style-type: none"> 4 个 STD 风扇仅支持 TDP <= 185 W 的处理器 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持 4 个 STD 风扇配置。 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持 STD 风扇配置。

表. 25: 8 × 2.5 英寸、16 × 2.5 英寸、24 × 2.5 英寸驱动器配置

标准操作支持 (符合 ASHRAE A2)	扩展环境 40°C 操作支持 (符合 ASHRAE A3 标准)	扩展环境 45°C 操作支持 (符合 ASHRAE A4 标准)
<ul style="list-style-type: none"> 使用 STD 风扇时, 以下 OCP 3.0 和 NIC 仅支持带散热规格为 85C 并且电源 ≤ 1.2 W 的光缆 <ul style="list-style-type: none"> Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28 Broadcom PCIe QP 25G NVIDIA CX6-LX PCIe 双端口 25G SFP28 (在插槽 6 中) 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持 CPU TDP > 120 W 的 8 个 STD 风扇配置。 TBU 不受支持。 不支持不符合戴尔标准的外围设备卡和通道设备 (FW) 卡。 不支持 NIC 功耗 ≥ 25 W。例如: CX6 卡。 不支持 OCP 传输速率 > 25 G 或冷却层 > 10。 需要规格为 85C 的光缆。 需要两个 PSU。在 PSU 故障的情况下, 系统性能可能会降低。 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持处理器 TDP > 165 W 的 4 个 HPR 风扇配置。 TBU 不受支持。 不支持 BOSS M.2 模块。 不支持不符合戴尔标准的外围设备卡和通道设备 (FW) 卡。 NIC 功耗 ≥ 25 W。例如: CX6 卡。 不支持 OCP 传输速率 > 25 G 或冷却层 > 10。 需要规格为 85C 的光缆。 需要两个 PSU。在 PSU 故障的情况下, 系统性能可能会降低。

表. 26: 8 个 3.5 英寸 × 8 个 NVMe 驱动器配置

标准操作支持 (符合 ASHRAE A2)	扩展环境 40°C 操作支持 (符合 ASHRAE A3 标准)	扩展环境 45°C 操作支持 (符合 ASHRAE A4 标准)
<p>HPR 风扇是必需的。</p>	<ul style="list-style-type: none"> TBU 不受支持。 不支持不符合戴尔标准的外围设备卡和通道设备 (FW) 卡。 不支持 NIC 功耗 ≥ 25 W。例如: CX6 卡。 不支持 OCP 传输速率 > 25 G 或冷却层 > 10。 需要规格为 85C 的光缆。 需要两个 PSU。在 PSU 故障的情况下, 系统性能可能会降低。 	<ul style="list-style-type: none"> 不支持 CPU TDP > 165 W 的 4 个 HPR 风扇配置。 TBU 不受支持。 不支持 BOSS M.2 模块。 不支持不符合戴尔标准的外围设备卡和通道设备 (FW) 卡。 NIC 功耗 ≥ 25 W。例如: CX6 卡。 不支持 OCP 传输速率 > 25 G 或冷却层 > 10。 需要规格为 85C 的光缆。 需要两个 PSU。在 PSU 故障的情况下, 系统性能可能会降低。